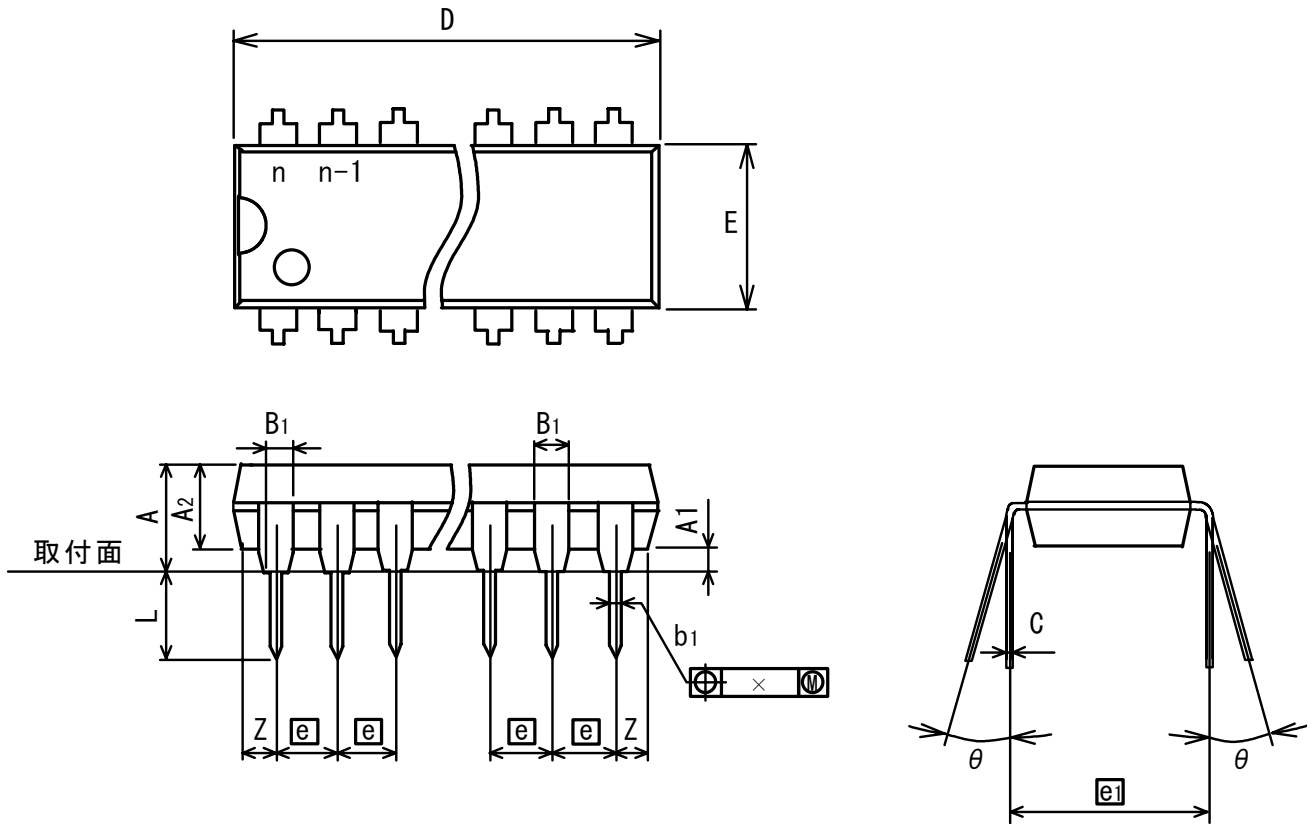


## 5. パッケージ外形図面 照合文字/記号

当社パッケージ図面に記載されている照合文字/記号は以下の通りです。

尚、以下の説明は例であり、個別の情報に関しては、営業窓口へお問い合わせください。

< リード挿入型 >

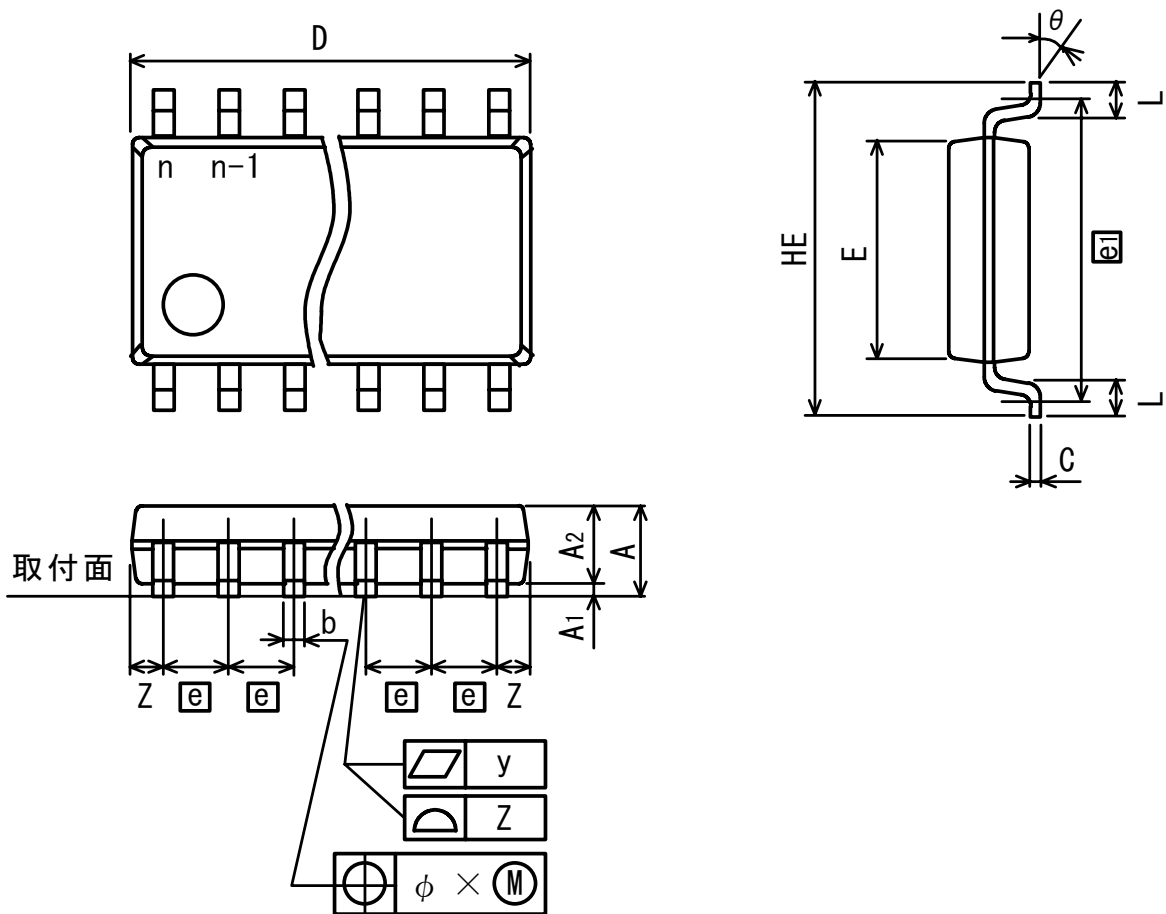


記号	呼称	説明
A	取り付け高さ	基板取付け面からパッケージ本体のモールド上面までの高さ
A1	スタンドオフ	基板取付け面とパッケージ本体のモールド下面までの距離
A2	本体高さ	パッケージ本体 (モールド部) の高さ
b1	端子幅	取付け穴へ挿入する端子幅
B1	最大端子幅	端子の最大幅
C	端子厚	端子の厚さ
D	パッケージ長	端子を平行にした際のパッケージ本体長さ (モールド長)
E	パッケージ幅	端子を除いたパッケージ本体幅 (モールド幅)

記号	呼称	説明
e	端子直線間隔	端子中心直線距離 (リードピッチ)
e1	端子長さ	幅方向の端子間距離 (ロースペース)
$\theta$	端子角度	取付け面に対して垂直方向の端子広がり角度
Z	オーバーハング	最も端にある端子の中心からパッケージ本体 (モールド部) までの距離
$\oplus$	位置度	外形図中において端子中心位置精度を表す
$\textcircled{M}$	最大実体公差	外形図中 (端子中心位置精度) における最大許容範囲を表す
MAX	最大値	外形寸法上の最大値を表す
MIN	最小値	外形寸法上の最小値を表す

# パッケージ外形図面 照合文字/記号

< 表面実装型 >



記号	呼称	説明
A	取り付け高さ	基板取付け面からパッケージ本体のモールド上面までの高さ
A1	スタンドオフ	基板取付け面とパッケージ本体のモールド下面までの距離
A2	本体高さ	パッケージ本体(モールド部)の厚さ
b1	端子幅	端子の幅
C	端子厚	端子の厚さ
D	パッケージ長	端子を平行にした際のパッケージ本体長さ(モールド長)
E	パッケージ幅	端子を除いたパッケージ本体幅(モールド幅)
e	端子直線間隔	端子中心直線距離(リードピッチ)
e1	端子長さ	幅方向の端子間距離(ロースペース)

記号	呼称	説明
$\theta$	端子角度	取付け面に対して垂直方向の端子広がりがり角度
Z	オーバーハング	最も端にある端子の中心からパッケージ本体(モールド部)までの距離
$\square$	平坦度	端子下面(基板実装面)の平坦の状態を表す
$\cup$	輪郭度	端子下面(基板実装面)の輪郭の状態を表す
$\oplus$	位置度	外形図中において端子中心位置精度を表す
(M)	最大実体公差	外形図中(端子中心位置精度)における最大許容範囲を表す
MAX	最大値	外形寸法上の最大値を表す
MIN	最小値	外形寸法上の最小値を表す